

VMEbus Backplanes



LKVB Backplane은 신호의 상호간섭 및 전달지연을 최소화하고, 임피던스 정합이 용이하도록 전기적인 특성을 고려하여 패턴과 각 층간의 구조를 특수하게 설계하였습니다. 고속/고성능보드 장착시 발생할 수 있는 전원의 급격한 동요를 억제할 수 있도록 설계하는 등 LKVB 시리즈는 IEEE 1014 Rev.D의 모든 규격을 만족합니다.

■특장점

- 인접한 신호선 간의 상호간섭을 최소화하기 위한 독특한 라우팅 기법사용
- 보드 간 임피던스 정합용이
- 신호선의 전달 지연 시간 최소화
- 고신뢰도 및 고성능을 위한 다층 설계
- 신뢰도 향상을 위해 100% Press-fit 기법 사용
- A24/D16까지 지원(J1)
- A32/D32까지 지원(J2)
- Jumpering의 번거로움을 제거 (Automatic Jumpering)
- 5신호선 응용 단지 제공(J1)(GND, +5V, ACFAIL, SYSFAIL, SYSRESET)

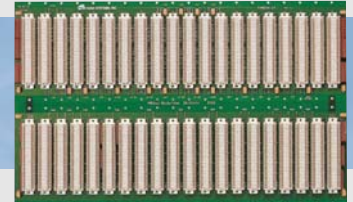
■Specification

Item	Spec	Item	Spec	Item	Spec
Transmission rate	80MB(J1+J2)	Humidity	5~90%	Power Supply	DC +5V, +12V, -12V
Design	Multilayer PCB	Connector	All Press-fit	Resistance on signal lines	1Ω
Impedance for Signal	60Ω±5Ω	PC B	FR-4(t2.4/3.2)		
Temperature range	Storage : -40 ~ +85℃	Termination	Passive On Board	Jumper	NO
	Operaton : -25 ~ +70℃				

■주문사양(Ordering Information)

J1			J2			Monolithic(J1+J2)		
Model No.	Slot Count	DIM(W)	Model No.	Slot Count	DIM(W)	Model No.	Slot Count	DIM(W)
LKVB-3J1	3	56.4	LKVB-3J2	3	56.4	LKVB-3M	3	56.4
LKVB-5J1	5	97.1	LKVB-5J2	5	97.1	LKVB-5M	5	97.1
LKVB-7J1	7	137.7	LKVB-7J2	7	137.7	LKVB-7M	7	137.7
LKVB-9J1	9	178.4	LKVB-9J2	9	178.4	LKVB-9M	9	178.4
LKVB-10J1	10	198.7	LKVB-10J2	10	198.7	LKVB-10M	10	198.7
LKVB-12J1	12	239.3	LKVB-12J2	12	239.3	LKVB-12M	12	239.3
LKVB-15J1	15	300.3	LKVB-15J2	15	300.3	LKVB-15M	15	300.3
LKVB-17J1	17	340.9	LKVB-17J2	17	340.9	LKVB-17M	17	340.9
LKVB-20J1	20	401.8	LKVB-20J2	20	401.8	LKVB-20M	20	401.8
LKVB-21J1	21	422.2	LKVB-21J2	21	422.2	LKVB-21M	21	422.2

VMEbus64 Backplanes



LKVB64 Backplane은 기존의 VMEbus 장비와의 완벽한 호환성을 유지하면서도 성능을 향상시킨 제품으로 기존 Backplane에 비해 전송 속도가 2배 이상 향상되었으며, 또한 3.3V의 전원을 지원하므로 보드에 별도의 전원관련 회로 추가없이 바로 사용할 수 있습니다. VMEB64 Extension의 모든 규격을 만족하는 안정적인 제품입니다.

■특장점

- 신호선 간의 상호 간섭을 최소화하기 위한 독특한 라우팅 기법 사용
- 보드간 임피던스 종합 용이
- Manual Daisy Chaining
- 신호선의 전달 지연 시간 최소화
- 고신뢰, 고성능을 위한 다층 설계
- 신뢰도 향상을 위한 Press-fit기법
- 고속의 데이터 전송 : A64/D64 지원
- 5Row Connector : C96 Connector와 호환 가능
- +3.3V 전원 지원

■Specification

Item	Spec	Item	Spec	Item	Spec
Transmission rate	120Mbytes/s(MB LT)	Humidity	5 ~ 90%	Power Supply	DC +5V, +12V, -12V, +3.3V
Design	Multilayer PCB	Termination	On Board	Base Material	FR-4(t3.2)
Impedance for Signal	60Ω±5Ω	Connectbr	All Press-fit	Resistance on signal lines	1Ω
Temperature range	Storage -40 ~ +85℃	Wire-wrap pins	ACFAIL, GND +5V, SYSFAIL		
	Operaton: -25 ~ +70℃		SYSRESET		

■주문사양(Ordering Information)

Monolithic(J1+J2)								
Model No.	Slot Count	DIM	Model No.	Slot Count	DIM(W)	Model No.	Slot Count	DIM(W)
LKV/B64-5M	5	103.1	LKV/B64-10M	10	204.7	LKV/B64-20M	20	407.9
LKV/B64-7M	7	143.7	LKV/B64-12M	12	245.3			
LKV/B64-9M	9	184.4	LKV/B64-15M	15	306.3			